



FM5821_V8 制板说明:

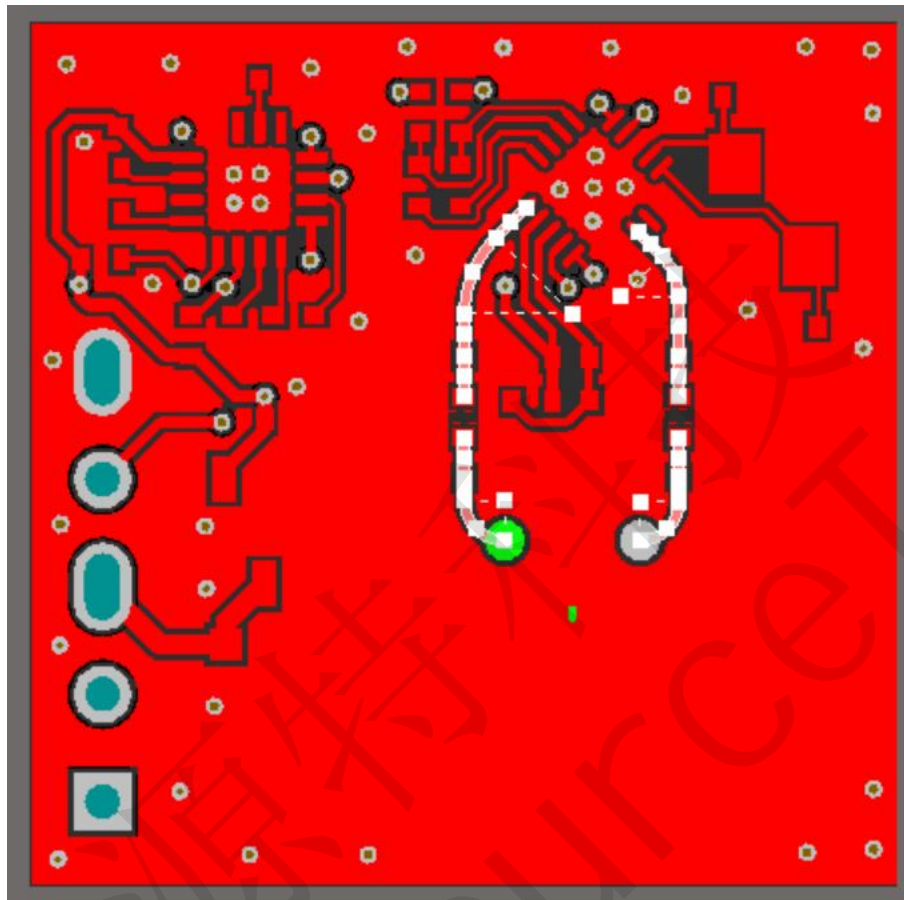
技术联系人:	0755-27595155	传真	
邮件地址:	Info@ChipSourceTek.com	交期	
板名:			
层数	4	第三层为空层	
数量			
板材类型	FR-4	可混压	
完成板厚及公差 (mm)	1.6+/-0.1mm (备注)		
铜箔要求 (基铜)	0.035/0.0152/0.0152/0.035mm		
完成铜厚	0.035/0.0152/0.0152/0.035mm	满足阻抗 可调	
单元尺寸 (mm)	按照文件尺寸		
每个拼板中的单元数量			
阻焊	YES	绿色/高温阻焊油	
可剥离阻焊	NO		
碳油	NO		
字符	YES	白色	
阻焊覆盖	过孔盖油		
表面处理	表面无铅喷锡		
过孔要求			
文件格式及版本			
外形	铣		
标记			
叠层顺序	按文件 (备注)		
验收标准	IPCII		
其他	ROHS		

备注:

1. 第一层为 TOP, 第二层为 GND, 第三层为**空层**, 第四层为 Bottom。
2. 要求使用 **FR-4** 板材, **FR-4** 介电常数 4.6 +/-0.1。阻焊 介电常数 3.8 走线面上阻焊 0.5mil, 基材上阻焊 0.8mil
3. 要求控制射频线路阻抗 (线宽 0.238mm, 到地间距 0.127mm 已设定, 可更改, 阻抗计算约为 50 欧姆)
4. 要求 top 层表面完成铜箔厚度为 **0.035mm**; 出货报告须注明阻抗控制线的线宽, 到地间距, 以及切片表面铜箔厚度和每层介质厚度。



要求 50 欧姆阻抗控制的白色线路如下图：



成品板厚：1.6MM(参考)

层名	材料	厚度 (mil)	厚度 (mm)
L1	外层铜厚1oz	1.38	0.0350
PP	7628 RC49% 8.6mil	8.28	0.2104
L2	内层铜厚	0.60	0.0152
芯板	1.1mm H/HOZ 含铜	41.93	1.0650
L3	内层铜厚	0.60	0.0152
PP	7628 RC49% 8.6mil	8.28	0.2104
L4	外层铜厚1oz	1.38	0.0350